

DiClad 522

基材=ガラスクロス・PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0010(@1MHz), 0.0022(@10GHz)

当社標準在庫品=● メーカー標準品=○

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er					厚さ詳細		
	2.45 ±0.05	2.48 ±0.05	2.50 ±0.05	2.55 ±0.05	2.60 ±0.05	[mm]*	[インチ]	表示形式
0.17	—	—	○	—	—	0.165 ±0.018	0.0065 ±0.0007	誘電体
0.25	—	○ ³⁵	○ ¹⁸	—	—	0.254 ±0.025	0.010 ±0.001	誘電体
0.33	—	—	● ³⁵	—	—	0.328 ±0.031	0.0129 ±0.0012	誘電体
0.4	● ¹⁸	—	—	—	—	0.373 ±0.038	0.0147 ±0.0015	誘電体
0.4	—	—	○	○	—	0.381 ±0.038	0.015 ±0.0015	銅箔含む
0.5	○	—	○	—	—	0.508 ±0.051	0.020 ±0.002	銅箔含む
0.6	—	—	○	—	● ¹⁸	0.610 ±0.051	0.024 ±0.002	銅箔含む
0.8	○	—	○	○	●	0.787 ±0.051	0.031 ±0.002	銅箔含む
1.0	—	—	—	—	○	1.016 ±0.076	0.040 ±0.003	銅箔含む
1.2	—	—	○	○	○	1.194 ±0.076	0.047 ±0.003	銅箔含む
1.6	○	—	○	● ¹⁸	● ³⁵	1.575 ±0.076	0.062 ±0.003	銅箔含む
2.4	—	—	—	○	—	2.362 ±0.102	0.093 ±0.004	銅箔含む
3.2	—	—	● ³⁵	—	○	3.175 ±0.127	0.125 ±0.005	銅箔含む
4.8	—	—	○	—	—	4.750 ±0.152	0.187 ±0.006	銅箔含む
6.4	—	—	○	—	—	6.350 ±0.152	0.250 ±0.006	銅箔含む

当社標準在庫品(両面・電解銅箔張り)=●18μm, 35μm両方共 ●¹⁸18μm品のみ ●³⁵35μm品のみ
 クラッディング 標準品=18μm両面, 35μm両面電解銅箔 その他の銅箔厚、圧延銅箔も可能です。
 基板サイズ 当社標準サイズ=406mm×914mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm

DiClad 880

基材=ガラスクロス・PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0008(@1MHz), 0.00085(@10GHz)

当社標準在庫品=●

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	当社 標準 在庫品	厚さ詳細		
			[mm]*	[インチ]	表示形式
0.13	2.17 ±0.02	● ¹⁸	0.127 ±0.013	0.005 ±0.0005	誘電体
0.25		● ¹⁸	0.254 ±0.025	0.010 ±0.001	
0.4		● ¹⁸	0.381 ±0.025	0.015 ±0.001	
0.5			0.508 ±0.038	0.020 ±0.0015	
0.6			0.610 ±0.051	0.024 ±0.002	
0.64			0.635 ±0.051	0.025 ±0.002	
0.8		● ¹⁸	0.762 ±0.051	0.030 ±0.002	
1.0			1.016 ±0.051	0.040 ±0.002	
1.27			1.270 ±0.051	0.050 ±0.002	
1.6		●	1.524 ±0.051	0.060 ±0.002	
2.0			2.007 ±0.076	0.079 ±0.003	
2.4			2.362 ±0.076	0.093 ±0.003	
3.2			3.175 ±0.102	0.125 ±0.004	

当社標準在庫品(両面・圧延銅箔張り)=●18μm, 35μm両方共 ●¹⁸18μm品のみ ●³⁵35μm品のみ
 クラッディング 標準品=18μm両面, 35μm両面圧延銅箔 その他の銅箔厚、電解銅箔、金属裏打ち、IM低減仕様可能です。
 基板サイズ 当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm

IsoClad 917

基材=ガラスマット・PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0013(@10GHz)

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.13	2.17 ±0.04	0.127 ±0.018	0.005 ±0.0007	誘電体
0.25		0.254 ±0.025	0.010 ±0.001	
0.4		0.381 ±0.038	0.015 ±0.0015	
0.5		0.508 ±0.051	0.020 ±0.002	
0.8		0.787 ±0.051	0.031 ±0.002	
1.2		1.143 ±0.076	0.045 ±0.003	
1.6		1.575 ±0.076	0.062 ±0.003	

クラッディング 標準品=18μm両面, 35μm両面圧延銅箔 その他の銅箔厚、電解銅箔、金属裏打ち可能です。
 基板サイズ 当社標準サイズ=304mm×457mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm

※ 1インチ=25.4mmにて換算

ここに記載したのは主要製品です。他の厚さ・サイズなど、別仕様を御希望の場合は、一度お問合せ下さい。

AD-Cシリーズ(量産向け低価格品)

AD250C

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0014(@10GHz)

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.5	2.50 ±0.04	0.508 ±0.051	0.020 ±0.002	誘電体
0.8		0.762 ±0.051	0.030 ±0.002	
1.6		1.524 ±0.076	0.060 ±0.003	
クラディング	標準品=18μm両面, 35μmRT銅箔			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

AD255C

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0014(@10GHz)

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.8	2.55 ±0.04	0.762 ±0.051	0.030 ±0.002	誘電体
1.6		1.524 ±0.076	0.060 ±0.003	
クラディング	標準品=18μm両面, 35μmRT銅箔			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

AD300C

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0020(@10GHz)

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.8	2.97 ±0.05	0.762 ±0.051	0.030 ±0.002	誘電体
1.6		1.524 ±0.076	0.060 ±0.003	
クラディング	標準品=18μm両面, 35μmRT銅箔			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

AD, AD-Aシリーズ

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板

メーカ標準品=○

厚さ 呼称 [mm]	AD260A	AD320A	AD410	AD450	厚さ詳細(代表値)		
	誘電率 Er				[mm]*	[インチ]	表示形式
	2.60 ±0.04	3.20 ±0.04	4.10 ±0.12	4.50 ±0.25			
0.25	—	—	—	○	0.254	0.010	誘電体
0.5	—	—	—	○	0.508	0.020	
0.8	—	○	○	○	0.762	0.030	
1.0	—	○	—	○	1.016	0.040	
1.6	—	—	—	○	1.524	0.060	
1.6	—	○	○	—	1.575	0.062	
3.2	○	○	○	—	3.175	0.125	
誘電正接 (@10GHz)	0.0017	0.0032	0.003	0.0035			
クラディング	標準品=18μm両面, 35μm両面電解銅箔 その他の仕様はお問い合わせ下さい。						
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm						

※ 1インチ=25.4mmにて換算

ここに記載したのは主要製品です。他の厚さ・サイズなど、別仕様を御希望の場合は、一度お問合せ下さい。

CLTEシリーズ (温度変化に対しても誘電率が一定に保たれます)

CLTE-XT

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0012(@10GHz)

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.13	2.79 ±0.03	0.130 ±0.013	0.0051 ±0.0005	誘電体
0.24	2.89 ±0.03	0.239 ±0.018	0.0094 ±0.0007	
0.5	2.92 ±0.03	0.508 ±0.025	0.020 ±0.001	
0.64	2.94 ±0.03	0.635 ±0.025	0.025 ±0.001	
0.8	2.94 ±0.03	0.762 ±0.025	0.030 ±0.001	
1.0	2.94 ±0.03	1.016 ±0.051	0.040 ±0.002	
1.15	2.94 ±0.03	1.143 ±0.051	0.045 ±0.002	
1.6	2.94 ±0.03	1.524 ±0.051	0.060 ±0.002	
3.0	3.01 ±0.03	3.048 ±0.076	0.120 ±0.003	
クラディング	標準品=18μm両面, 35μm両面電解銅箔 その他の銅箔厚、圧延銅箔、金属裏打ち、IM低減仕様可能です。			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

CLTE-AT

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0013(@10GHz)

CLTE-XTの低価格タイプ

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.13	3.00 ±0.04	0.127 ±0.013	0.005 ±0.0005	誘電体
0.25		0.254 ±0.018	0.010 ±0.0007	
0.4		0.381 ±0.025	0.015 ±0.001	
0.5		0.508 ±0.038	0.020 ±0.0015	
0.64		0.635 ±0.051	0.025 ±0.002	
0.8		0.762 ±0.051	0.030 ±0.002	
1.0		1.016 ±0.064	0.040 ±0.0025	
1.27		1.270 ±0.064	0.050 ±0.0025	
1.6		1.524 ±0.076	0.060 ±0.003	
3.2		3.02 ±0.04	3.175 ±0.152	
クラディング	標準品=18μm両面, 35μm両面RT電解銅箔 その他の仕様はお問い合わせ下さい。			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

※1インチ=25.4mmにて換算

ここに記載したのは主要製品です。他の厚さ・サイズなど、別仕様を御希望の場合は、一度お問合せ下さい。

TC350 (放熱用・高熱伝導性基板)

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.002(@10GHz)

熱伝導率(Z方向)=1.0 W/mK

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.13	3.50 ±0.05	0.127 ±0.013	0.005 ±0.0005	誘電体
0.25		0.254 ±0.018	0.010 ±0.0007	
0.4		0.381 ±0.025	0.015 ±0.0010	
0.5		0.508 ±0.038	0.020 ±0.0015	
0.64		0.635 ±0.051	0.025 ±0.0020	
0.8		0.762 ±0.051	0.030 ±0.0020	
1.0		1.016 ±0.076	0.040 ±0.0030	
1.27		1.270 ±0.076	0.050 ±0.0030	
1.6		1.524 ±0.076	0.060 ±0.0030	
3.2		3.175 ±0.203	0.125 ±0.0080	
クラッディング	標準品=18μm両面, 35μm両面電解銅箔 その他の銅箔厚、圧延銅箔、金属裏打ち仕様可能です。			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

TC600 (放熱用・高熱伝導性基板)

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.002(@10GHz)

熱伝導率(Z方向)=1.1 W/mK

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	厚さ詳細		
		[mm]*	[インチ]	表示形式
0.25	6.15 ±0.15	0.254 ±0.018	0.010 ±0.0007	誘電体
0.4		0.381 ±0.025	0.015 ±0.0010	
0.5		0.508 ±0.025	0.020 ±0.0010	
0.64		0.635 ±0.038	0.025 ±0.0015	
0.8		0.762 ±0.051	0.030 ±0.0020	
1.0		1.016 ±0.051	0.040 ±0.0020	
1.27		1.270 ±0.051	0.050 ±0.0020	
1.6		1.524 ±0.076	0.060 ±0.0030	
2.3		2.286 ±0.102	0.090 ±0.0040	
3.2		3.175 ±0.102	0.125 ±0.0040	
クラッディング	標準品=18μm両面, 35μm両面電解銅箔 その他の銅箔厚、圧延銅箔、金属裏打ち可能です。			
基板サイズ	当社標準サイズ=457mm×609mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm			

AD1000

基材=ガラスクロス・セラミック配合PTFE基板/誘電正接tanδ=0.0023(@10GHz)

厚さ 呼称 [mm]	比誘電率 Er	当社 標準 在庫品	厚さ詳細		
			[mm]*	[インチ]	表示形式
0.4	9.7 ±0.35	—	0.381 ±0.038	0.015 ±0.0015	誘電体
0.5	10.0 ±0.35	—	0.508 ±0.051	0.020 ±0.002	
0.64	10.2 ±0.35	●	0.635 ±0.051	0.025 ±0.002	
0.8	10.35 ±0.35	●	0.762 ±0.051	0.030 ±0.002	
1.27	10.6 ±0.35	●	1.270 ±0.076	0.050 ±0.003	
1.6	10.7 ±0.35	●	1.499 ±0.076	0.059 ±0.003	
3.2	10.9 ±0.35	—	3.226 ±0.152	0.127 ±0.006	
当社標準在庫品(両面・電解銅箔張り)=●18μm, 35μm両方共 ● ¹⁸ 18μm品のみ ● ³⁵ 35μm品のみ					
クラッディング	標準品=18μm両面, 35μm両面電解銅箔 その他の銅箔厚、圧延銅箔、金属裏打ち、IM低減仕様可能です。				
基板サイズ	当社標準サイズ=304mm×457mm 工場製造サイズ=914mm×1220mm				

*1インチ=25.4mmにて換算

ここに記載したのは主要製品です。他の厚さ・サイズなど、別仕様を御希望の場合は、一度お問合せ下さい。

Bonding Film (PTFE接着用フィルム)

PTFE基板用の接着フィルム。PTFE面同士の接着が可能で、電気特性的にも非常に相性が合います。

厚さ* [μm]	厚さ [インチ]	製品番号	比誘電率 Er	融点 [°C]	当社標準品 サイズ	受注生産品 サイズ
38	0.0015	6700-015	2.35 ±0.10	204	幅609mm×長9m	幅609mm×長45m, 228m
76	0.0030	6700-030	2.35 ±0.10	204	-	幅609mm×長9m
51	0.0020	6250-020	2.32 ±0.10	121	幅609mm×長9m	幅609mm×長45m

※ 1インチ=25.4mmにて換算

ここに記載したのは主要製品です。他の厚さ・サイズなど、別仕様を御希望の場合は、一度お問合せ下さい。